

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Designed for Intel, AMD, Via, Freescale, NVidia and Texas Instrument processors that employ a BGA socket

Provides industry-leading conduction cooling performance, 10% improvement over current conduction cooling methods

Patent pending conduction cooling solution for small form factor electronics

Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape

Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad

Compatible with Interscale C enclosures

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Ilość opakowania	Głębokość	Szerokość
------------------	-----	----------------	------------------	-----------	-----------

24830-005	Przewód cieplny	Przypadki	1	22 mm	22 mm
-----------	-----------------	-----------	---	-------	-------

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE